



## Rezultate remarcabile pentru studenții ETTI la concursul TIE 2025 de la Brașov

O echipă de studenți de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a obținut rezultate remarcabile la cea de-a 34-a ediție a prestigiosului concurs profesional TIE (Tehnici de Interconectare a Echipamentelor), desfășurat în perioada 2-5 aprilie 2025, la Universitatea “Transilvania” din Brașov. Această competiție reunește anual cei mai buni studenți din universitățile românești de profil. Aceștia sunt invitați să găsească o serie de soluții inovatoare la probleme complexe formulate de industrie și mediul academic.



Desfășurat pe mai multe secțiuni, Concursul Profesional Studențesc TIE și-a desemnat câștigătorii pentru anul 2025, printre care s-au distins studenții participanți ai facultății clujene ETTI:

- **Secțiunea TIE E Plus:**
  - Locul I: Octavian-Constantin AXINTE
  - Locul II: Cătălin-Ionuț OPRIȚA



- **Secțiunea TIE T Plus:**
  - Locul I: Daniel Andrei BULUGHEANĂ
  - Locul II: Alexandru Andrei POPOVICI
  - Locul III: Alin TANȚĂU
- **Secțiunea TIE-E:**
  - Mențiune: Vlad CRISTESCU
- **Secțiunea TIE Micro:**
  - Locul I: Alexandru-Andrei ALEXA
  - Locul II: Andrei KISS
  - Mențiune: Gheorghe MELINTE

Din echipa clujeană a ETTI au mai făcut parte studenții Raul HORGOSȘ și Andrei ZĂULEȚ. Echipele studențești ETTI au fost coordonate de Conf.dr.ing. Liviu VIMAN, Conf.dr.ing. Cristian FĂRCAȘ, Conf.dr.ing. Mihai DĂRĂBAN și Șef lucrări dr.ing. Raul FIZEȘAN.



Concursul Profesional Studențesc TIE reprezintă o platformă valoroasă unde studenții sunt provocați să abordeze probleme reale din industria electronică, cu un accent special pe electronic packaging, un aspect important al proiectării și producției de produse electronice. Colaborarea constantă dintre mediul academic și cel industrial are ca scop stimularea studenților să își dezvolte abilitățile în diverse tehnici CAD pentru dezvoltarea



circuitelor imprimate (PCB), simularea circuitelor pentru Signal Integrity, Power Integrity și Thermal Integrity, precum și în design-ul System-in-Package.

Acest concurs profesional studențesc, al cărui obiectiv este promovarea proiectării tehnologice asistate de calculator (CAE-CAD-CAM) a modulelor electronice, reunește participanți din mediul universitar românesc încă din anul 1992.